

2024(令和6)年度

学校推薦型選抜(公募)
入学者選抜要項

システムデザイン工学部・未来科学部・工学部・理工学部・工学部第二部

TDU 東京電機大学

目次

大学のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)	1
各学部のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)	1
1. 募集人員	4
2. 選考日程等	4
3. 出願資格及び推薦の要件	5
4. 出願について	10
5. 選考方法	12
6. 受験に際しての注意事項	18
7. 合格発表	19
8. 入学手続について	19
9. 入学手続金	20
10. 第2年次以降の学費について	21
11. 入学前教育の実施について	22
12. 入学後に使用するパソコンについて	22
13. その他	23

巻末

- ・インターネット出願の手引き
- ・合否照会の方法
- ・入学手続の方法

大学のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)

■大学【学士課程】のアドミッションポリシー

東京電機大学は、工学・理学・情報分野における科学技術に興味を持ち、志望する各学部・学科(学系)の教育方針やカリキュラム、研究の内容、求める学生像を十分理解し、本学の教育・研究理念である「技術は人なり」の精神のもと、卒業後、自立した科学技術者として社会への貢献を目指す学生を求めます。

なお、本学では、各学部・学科(学系)のアドミッション・ポリシーを踏まえて、高等学校等の課程や実社会で学んだ以下の学力の3要素を総合的・多面的に評価するため、多種多様な入学者選抜を実施し入学者を受け入れています。

- 1 高等学校等の課程で学ぶ知識・技能(特に外国語、数学、理科、国語など)
- 2 思考力・判断力・表現力等の能力
- 3 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

各学部のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)

システムデザイン工学部

システムデザイン工学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、社会環境の変化と科学技術の革新に対応でき、社会が必要とするイノベーションを引き起こせる専門技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1)求める学生像

- 1 システムデザイン工学部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
- 2 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、ひとの魅力的な生活空間の創造に必要な「モノ・コト」をデザインし具現化できる技術者を目指す学生
- 3 システムデザイン工学部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2)入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、理科(物理・化学)、英語及び国語(現代文)は、十分な基礎学力を身に付けておくこと。

未来科学部

未来科学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、自ら問題を発見し解決する能力（プロの能力）と広い視野と、時代の方向性を見通すことのできる心構え（豊かな教養）を併せ持つ技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持ち、社会への貢献に強い関心を有する学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 未来科学部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、豊かな教養を持つ技術者をを目指す学生
3. 未来科学部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、理科（物理・化学）、英語及び国語（現代文）は、十分な基礎学力を身に付けておくこと。

工学部

工学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、安全で快適な社会の発展に貢献できる技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 工学部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、安全で快適な社会の発展に貢献できる技術者をを目指す学生
3. 工学部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、理科（物理・化学）及び英語は、十分な基礎学力を身につけておくこと。

理工学部

理工学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに従い、高度な専門性と豊かな人間性を兼ね備えた「未来型科学技術者」を養成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技術や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 理工学分野に強く興味を持ち、理工学部で修得した知識と技術を活かして未来の社会で活躍することを望む学生
2. 各種のプロジェクト科目や学部共通教育科目を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、幅広い教養を備えた未来型科学技術者を目指す学生
3. 理工学部における主コース・副コースの選択を通して、主体性を持って自らの学びを追求し、さらに多様な人々と協働して問題を解決しようとする意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技術を学習しておくこと。特に数学及び英語は、理工学部の全学系で求められる知識であるため、十分な基礎学力を身に付けておくこと。加えて、理工学部の各学系が求める教科に関する基礎学力を身に付けておくこと。

工学部第二部

工学部第二部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに則り、実社会で真に必要とされる能力を備えた技術者を育成します。本学の教育・研究理念である「技術は人なり」に共感し、次に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲を持った学生を求めます。

(1) 求める学生像

1. 工学部第二部の各分野での技術に強く興味を持ち、基礎学力を身につけている学生
2. 多様な学部共通科目の履修を通して、思考力・判断力・表現力・倫理観を修得し、安全で快適な社会の発展に貢献できる技術者をを目指す学生
3. 工学部第二部における多様な専門科目の履修を通して、主体性を持って多様な人々と協働して学び、自ら課題を発見し、解決する意欲のある学生

(2) 入学前に学習しておくことが望ましい内容

高等学校等の課程全般の基礎的な知識・技能を学習しておくこと。特に数学、物理及び英語は、十分な基礎学力を身につけておくこと。

1. 募集人員

キャンパス	学部・学科	学科・学系	募集人数
東京千住キャンパス	システムデザイン工学部	情報システム工学科	若干名
		デザイン工学科	
	未来科学部	建築学科	
		情報メディア学科	
		ロボット・メカトロニクス学科	
	工学部	電気電子工学科	
		電子システム工学科	
		応用化学科	
		機械工学科	
		先端機械工学科	
		情報通信工学科	
	工学部第二部	電気電子工学科	
		機械工学科	
		情報通信工学科	
埼玉鳩山キャンパス	理工学部 理工学科	理学系	
		生命科学系	
		情報システムデザイン学系	
		機械工学系	
		電子情報・生体医工学系 ※1	
		建築・都市環境学系	

※1 2024年4月「電子情報・生体医工学系」開設

※2 他大学との併願は可能です。ただし、本学の他学科・学系との併願は認められません。

2. 選考日程等

摘要	日程
出願期間	2023年11月17日（金）～2023年11月28日（火） ※消印有効
受験票発行日	2023年12月11日（月）
選考日	2023年12月16日（土）（※全学科・学系対象） 2023年12月17日（日）（※一部学科のみ対象）
合格発表日	2023年12月22日（金）
第1回入学手続期間	2023年12月22日（金）～2024年1月5日（金）
第2回入学手続期間	2024年1月12日（金）～2024年1月22日（月）

3. 出願資格及び推薦の要件

システムデザイン工学部

次の条件を全て満たす者。

- (1) 2024年(令和6年)3月に高等学校(中等教育学校)を卒業見込みの者、または2023年(令和5年)3月に卒業した者。
- (2) 2024年(令和6年)3月に卒業見込みの者については、当該学校の第3学年1学期、または前期までの成績が下記の出願する学科の要件を満たすこと。(※印の注意事項もご確認ください。)なお、2023年3月に卒業した者については、下記の成績要件は問わない。

学科	要件
情報システム工学科	全体の学習成績の状況が3.5以上の者。
デザイン工学科	

※「全体の学習成績の状況」は、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

- (3) 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または、学校法人が設置した予備校の教員(クラス担任)等の推薦が受けられる者。

未来科学部

次の条件を全て満たす者。

- (1) 2024年(令和6年)3月に高等学校(中等教育学校)を卒業見込みの者、または2023年(令和5年)3月に卒業した者。
- (2) 2024年(令和6年)3月に卒業見込みの者については、当該学校の第3学年1学期、または前期までの成績が下記の出願する学科の要件を満たすこと。(※印の注意事項もご確認ください。)。
なお、2023年(令和5年)3月に卒業した者については、下記の出願する学科の要件の内、全体の学習成績の状況は問わない。

学科	要件
建築学科	数学Ⅲを履修中もしくは履修済みの者。 ※理数科の場合は、理数数学Ⅱと読み換える。 ※工業科の場合は、数学Ⅰ及び数学Ⅱと読み換える。
情報メディア学科	全体の学習成績の状況が3.5以上の者で数学Ⅲ及び物理を履修中もしくは履修済みの者。※理数科の場合は、理数数学Ⅱ及び理数物理と読み換える。
ロボット・メカトロニクス学科	数学Ⅲ及び物理を履修中もしくは履修済みの者。 ※理数科の場合は、理数数学Ⅱ及び理数物理と読み換える。

※建築学科及びロボット・メカトロニクス学科は、「全体の学習成績の状況」について、出願時の基準は設けないが、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

※情報メディア学科は、「全体の学習成績の状況」について、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

- (3) 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または、学校法人が設置した予備校の教員(クラス担任)等の推薦が受けられる者。

工学部

次の条件を全て満たす者。

- (1) 2024年(令和6年)3月に高等学校(中等教育学校)を卒業見込みの者、または2023年(令和5年)3月に卒業した者。
- (2) 2024年(令和6年)3月に卒業見込みの者については、当該学校の第3学年1学期、または前期までの成績が下記の出願する学科の要件を満たすこと。(※印の注意事項もご確認ください。)。
なお、2023年(令和5年)3月に卒業した者については、下記の出願する学科の要件の内、全体の学習成績の状況は問わない。

学科	要件
電気電子工学科	全体の学習成績の状況が3.5以上の者で数学Ⅲ及び物理を履修中もしくは履修済みの者(理数科の場合は、理数数学Ⅱ及び理数物理と読み換える)
電子システム工学科	
応用化学科	全体の学習成績の状況が3.5以上の者
機械工学科	全体の学習成績の状況が3.5以上の者で数学Ⅲ及び物理を履修中もしくは履修済みの者(理数科の場合は、理数数学Ⅱ及び理数物理と読み換える)
先端機械工学科	
情報通信工学科	全体の学習成績の状況が3.5以上の者で数学Ⅲを履修中もしくは履修済みの者(理数科の場合は、理数数学Ⅱと読み換える)

※「全体の学習成績の状況」は、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

- (3) 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または、学校法人が設置した予備校の教員(クラス担任)等の推薦が受けられる者。

理工学部

次の条件を全て満たす者。

- (1) 2024年(令和6年)3月に高等学校(中等教育学校)を卒業見込みの者、または2023年(令和5年)3月に卒業した者。
- (2) 2024年(令和6年)3月に卒業見込みの者については、当該学校の第3学年1学期、または前期までの成績が下記の出願する学系の要件を満たすこと。(※印の注意事項もご確認ください。)。
なお、2023年(令和5年)3月に卒業した者については、下記の出願する学系の要件の内、全体の学習成績の状況は問わない。

学系	要件
理学系	全体の学習成績の状況が3.5以上の者
生命科学系	なし
情報システムデザイン学系	全体の学習成績の状況が3.5以上の者
機械工学系	全体の学習成績の状況が3.5以上の者で物理を履修中もしくは履修済みの者 (理数科の場合は、理数物理と読み換える)
電子情報・生体医工学系	
建築・都市環境学系	全体の学習成績の状況が3.5以上の者

※「全体の学習成績の状況」は、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

※生命科学系は、「全体の学習成績の状況」について、出願時の基準は設けないが、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

- (3) 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または、学校法人が設置した予備校の教員等(クラス担任)の推薦が受けられる者。

工学部第二部

次の条件を全て満たす者。

- (1) 2024年(令和6年)3月に高等学校(中等教育学校)を卒業見込みの者、または2023年(令和5年)3月に卒業した者。
- (2) 2024年(令和6年)3月に卒業見込みの者については、当該学校の第3学年1学期、または前期までの成績が下記の出願する学科の要件を満たすこと。(※印の注意事項もご確認ください。)なお、2023年(令和5年)3月に卒業した者については、下記の成績要件は問わない。

学科	要件
電気電子工学科	全体の学習成績の状況が3.2以上の者
機械工学科	
情報通信工学科	

※「全体の学習成績の状況」は、大学教育に必要な基礎学力の状況を把握する指標として利用します。

- (3) 高校教員(校長、教頭、担任、進路指導)の推薦が受けられる者。または、学校法人が設置した予備校の教員(クラス担任)等の推薦が受けられる者。

4. 出願について

(1) 出願方法

巻末の「インターネット出願の手引き」を確認の上、手順に従って出願をしてください。

(2) 出願提出書類(日本語を使用してください。鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。)

提出書類	摘要
入学志願票	インターネット出願サイトにて、出願登録及び検定料納入後にマイページからダウンロード・印刷をしてください。 ※ 詳細は巻末の「インターネット出願の手引き」を参照。 ※ 理工学部 理学系の出願者は、個別面接〔口頭試問〕で希望する教科(科目)を、出願登録時に選択していただきます。 ※ 理工学部 生命科学系の出願者は、基礎学力テストで希望する教科(科目)を、出願登録時に選択していただきます。
推薦書	本学 Web サイトの学校推薦型選抜(公募)ページよりダウンロード・印刷をしてください。 【本学所定書式】 所定の事項(学力の3要素に関する評価を含む)を推薦者(高校教員や予備校の教員等)が記入し、厳封したもの。出願日から遡って3ヶ月以内に発行された推薦書を提出してください。 手書きまたは Word 形式での入力どちらでも構いません。 校印または推薦者捺印が必要です。
志望理由書	本学 Web サイトの学校推薦型選抜(公募)ページよりダウンロード・印刷をしてください。 【本学所定様式】 所定の事項を記入してください。
調査書	【出身学校長が作成し、厳封したもの】 出願日から遡って3ヶ月以内に発行された調査書を提出してください。

(3) 提出方法

インターネット出願サイトにて、出願登録及び検定料納入後にマイページから封筒貼り付け用「宛先ラベル」をダウンロード・印刷をしてください。印刷した貼付用「宛先ラベル」を各自で用意した角 2 サイズ以上の封筒に貼り、出願提出書類一式を同封して、郵便局窓口から簡易書留・速達で郵送してください。

(4) 提出書類についての注意事項

- ① 出願書類を受理した後は、原則として記載事項の変更及び出願書類の返還はいたしません。
- ② 出願書類に虚偽の記載及び不正な申告があった場合は、入学を認めないことがあります。

(5) 入学検定料の納入について

入学検定料 35,000 円

- コンビニエンスストア・クレジットカード・Pay-easy(ペイジー)でお支払いが可能です。
- 詳細は巻末の「インターネット出願の手引き」を参照してください。
- ※ 上記以外の方法(金融機関窓口、Pay-easy(ペイジー)を利用しないATM等)でのお支払いはできません。

(6) 受験票の発行について

受験票の送付はいたしません。志願者は、各自でダウンロード・印刷をしてください。受験票の発行方法は、巻末の「インターネット出願の手引き」を必ずご確認ください。

5. 選考方法

システムデザイン工学部

(1) 選考日及び選考会場

選考日	2023年12月16日(土)、17日(日) (12月17日(日)は、情報システム工学科の「個別面接」のみ実施します)	
集合時刻	12月16日(土)	【情報システム工学科、デザイン工学科】 11時00分(10時15分より受付開始)
	12月17日(日)	【情報システム工学科】 9時30分(9時00分より受付開始)または 13時30分(13時00分より受付開始) (集合時刻は、受験生ごとに異なりますので、受験票を確認してください)
集合場所	東京電機大学 東京千住キャンパス (選考会場(建物)については受験票を確認してください)	
選考開始時刻	12月16日(土)	【情報システム工学科、デザイン工学科】 11時30分
	12月17日(日)	【情報システム工学科】 10時00分 または 14時00分 (選考開始時刻は、集合時刻に応じて受験生ごとに異なります)

学科	選考内容及び時間	
	12月16日(土)	12月17日(日)
情報システム工学科	11:30~12:30 基礎学力テスト	10:00~または14:00~ 個別面接
デザイン工学科	(数学) 14:00~ 個別面接	

(2) 選考方法: 提出された書類と以下の選考方法により多面的・総合的に判定します。

学科	選考方法	出題範囲等
情報システム工学科	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
デザイン工学科	個別面接	提出書類を参考に質疑応答を行う。

※基礎学力テスト: 数学 60分 100点

個別面接: 1人 20分程度、5段階評価

※個別面接が終了した受験生から随時解散となります。

(1) 選考日及び選考会場

選考日	2023年12月16日(土)、17日(日) (12月17日(日)は、建築学科及び情報メディア学科の「個別面接」のみ実施します)	
集合時刻	12月16日(土)	【ロボット・メカトロニクス学科】 9時30分(9時00分より受付開始) 【建築学科、情報メディア学科】 11時00分(10時15分より受付開始)
	12月17日(日)	【建築学科、情報メディア学科】 9時30分(9時00分より受付開始) または 13時30分(13時00分より受付開始) (集合時刻は、受験生ごとに異なりますので、受験票を確認してください)
集合場所	東京電機大学 東京千住キャンパス (選考会場(建物)については受験票を確認してください)	
選考開始時刻	12月16日(土)	【ロボット・メカトロニクス学科】 10時00分 【建築学科、情報メディア学科】 11時30分
	12月17日(日)	【建築学科、情報メディア学科】 10時00分 または 14時00分 (選考開始時刻は、集合時刻に応じて受験生ごとに異なります)

学科	選考内容及び時間			
	12月16日(土)		12月17日(日)	
建築学科 情報メディア学科	11:30~12:30 基礎学力テスト (数学)		10:00~または14:00~ 個別面接	
ロボット・メカトロニクス学科			10:00~11:00 基礎学力テスト (物理)	14:00~ 個別面接

(2) 選考方法: 提出された書類と以下の選考方法により多面的・総合的に判定します。

学科	選考方法	出題範囲等
建築学科 情報メディア学科	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	学科適性を問う内容を含む。
ロボット・メカトロニクス学科	基礎学力テスト(物理)	物理基礎、物理
	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	学科適性を問う内容を含む。

※基礎学力テスト: 数学 60分 100点、物理 60分 100点

個別面接: 1人 20分程度、5段階評価

※個別面接が終了した受験生から随時解散となります。

(1) 選考日及び選考会場

選考日	2023年12月16日(土)
集合時刻	【機械工学科、先端機械工学科】 9時30分(9時00分より受付開始)
	【電気電子工学科、電子システム工学科、応用化学科、情報通信工学科】 11時00分(10時15分より受付開始)
集合場所	東京電機大学 東京千住キャンパス (選考会場(建物)については受験票を確認してください)
選考開始時刻	【機械工学科、先端機械工学科】 10時00分
	【電気電子工学科、電子システム工学科、応用化学科、情報通信工学科】 11時30分

学科	選考内容及び時間			
電気電子工学科	11:30~12:30 基礎学力テスト (数学)	14:00~ 個別面接(一部の学科では 口頭試問を含む)		
電子システム工学科				
応用化学科				
機械工学科				10:00~11:00 基礎学力テスト (物理)
先端機械工学科				
情報通信工学科				

(2)選考方法:提出された書類と以下の選考方法により多面的・総合的に判定します。

学科	選考方法	出題範囲等
電気電子工学科 電子システム工学科	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	物理(物理基礎、物理)の基礎知識に関する口頭試問を含む
応用化学科	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	化学(化学基礎、化学)の基礎知識に関する口頭試問を含む
機械工学科 先端機械工学科	基礎学力テスト(物理)	物理基礎、物理
	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	学科適性を問う内容を含む。
情報通信工学科	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	学科適性を問う内容を含む。

※基礎学力テスト:数学60分100点、物理60分100点

個別面接:1人20分程度、5段階評価

※個別面接が終了した受験生から随時解散となります。

(1) 選考日及び選考会場

選考日	2023年12月16日(土)
集合時刻	【生命科学系、建築・都市環境学系】 11時00分(10時15分より受付開始)
	【理学系、情報システムデザイン学系、機械工学系、電子情報・生体医工学系】 13時30分(13時00分より受付開始)
集合場所	東京電機大学 埼玉鳩山キャンパス (選考会場(建物)については受験票を確認してください)
選考開始時刻	【生命科学系、建築・都市環境学系】 11時30分
	【理学系、情報システムデザイン学系、機械工学系、電子情報・生体医工学系】 14時00分

学系	選考内容及び時間	
理学系 情報システムデザイン学系 機械工学系 電子情報・生体医工学系		14:00～ 個別面接(口頭試問を含む)
生命科学系	11:30～12:30 基礎学力テスト (生物または数学から1教科選択)	14:00～ 個別面接
建築・都市環境学系	11:30～12:30 基礎学力テスト(数学)	

(2) 選考方法: 提出された書類と以下の選考方法により多面的・総合的に判定します。

学系	選考方法	出題範囲等
理学系	個別面接	以下の3教科から出願時に選択した1教科の基礎知識に関する口頭試問を含む。 ① 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)): 指定されている範囲から、例えば2次関数、ベクトルや微積分などに関して、教科書の例題や章末問題と同程度の問題を幾つか出題する。 ② 物理(物理基礎、物理): 力学の分野で教科書の例題レベルとする。 ③ 化学(化学基礎、化学): 水溶液の濃度計算、中和滴定、気体の性質などに関する計算問題は教科書の例題レベル、元素や物質の性質、化学反応に関する知識を問う問題は教科書の本文に載っているものに限って出題する。
生命科学系	基礎学力テスト (生物または数学から1教科選択)	以下の2教科から出願時に選択した1教科の基礎学力テストを行う。 ① 生物(生物基礎、生物) ② 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ)
	個別面接	学系適性を問う内容を含む。
情報システムデザイン学系	個別面接	数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル))と英語(コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ)の基礎知識、および時事問題に関する口頭試問を含む。

機械工学系	個別面接	以下の2教科の基礎知識に関する口頭試問を含む。 ① 数学(数学Ⅱ、数学B(ベクトル)) (ア) 色々な関数(三角関数、指数関数、対数関数)【数学Ⅱ】 (イ) 微分積分【数学Ⅱ】 (ウ) 複素数と方程式【数学Ⅱ】 (エ) ベクトル【数学B】 ② 物理(物理基礎、物理) (ア) 運動 (イ) 熱 (ウ) 波
電子情報・生体医工学系	個別面接	以下の2教科の基礎知識に関する口頭試問を含む。 ① 数学(数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ): 三角関数、指数関数、対数関数、微分法、積分法から選択し、高等学校で学習した内容を説明すること。 ② 物理(物理基礎、物理): 運動方程式、仕事・エネルギー、クーロン力、電界・電位、コンデンサー、直流回路から選択し、高等学校で学習した内容を説明すること。なお、それぞれの選択は面接時に申告すること。
建築・都市環境学系	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(1.数列、2.ベクトル)、数学Ⅲ
	個別面接	学系適性を問う内容を含む。

※基礎学力テスト:数学 60分 100点、生物 60分 100点

個別面接:1人 20分程度、5段階評価

※個別面接が終了した受験生から随時解散となります。

(1) 選考日及び選考会場

選考日	2023年12月16日(土)
集合時刻	11時00分(10時15分より受付開始)
集合場所	東京電機大学 東京千住キャンパス (選考会場(建物)については受験票を確認してください)
選考開始時刻	11時30分

学科	選考内容及び時間	
電気電子工学科	11:30~12:10 基礎学力テスト(数学)	14:00~ 個別面接
機械工学科		
情報通信工学科		

(2)選考方法:提出された書類と以下の選考方法により多面的・総合的に判定します。

学科	選考方法	出題範囲等
電気電子工学科 機械工学科 情報通信工学科	基礎学力テスト(数学)	数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B (1.数列、2.ベクトル)
	個別面接	学科適性を問う内容を含む。

※基礎学力テスト:数学 40分 100点

個別面接:1人 20分程度、5段階評価

※個別面接が終了した受験生から随時解散となります。

6. 受験に際しての注意事項

- (1) 選考当日は、交通機関の遅れ等を考慮し、集合時刻に間に合うよう十分余裕をもって来場してください。
- (2) 受験時の宿泊は受験生が手配してください。
- (3) 選考日当日はインターネット出願サイトのマイページより印刷した受験票、生徒手帳(身分証明書)・**昼食**を持参し、指定の時間・場所に集合してください。
 - ※ 受験票の発行は巻末の「インターネット出願の手引き」をご参照ください。
 - ※ 基礎学力テストのみ、または個別面接のみ実施する選考日に該当する受験生は、昼休憩を挟まないため、昼食持参は不要です。
- (4) 受験票には印刷された内容以外の書き込みを行うことはできません。
- (5) 携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類は選考会場に入る前に必ず電源を切っておいてください。受験票への書き込みや、許可されたもの以外をカバンにしまわず、身につけていたり手に持っていたりすると不正行為と見なされることがあります。
- (6) 基礎学力テストにおいて、選考開始時間に遅刻した場合でも、基礎学力テストの選考終了時刻まで受験を認めます。
- (7) 個別面接において、集合時刻に遅刻した者は、受験できないことがあります。
- (8) 受験生並びに教職員のマスク着用は「個人の判断」に委ねます。マスクを着用される場合は、本人確認の為に一時的に着脱をお願いすることがあります。
- (9) 体調不良等の場合は、他の受験生や監督等への感染の恐れがありますので、受験はできません。追試験等の措置はございませんので、体調管理等に努めてください。
- (10) 今後の社会的動向等の変化により、選考方法や実施方法に変更が生じる可能性があります。その際には、本学 Web サイトの学校推薦型選抜(公募)専用ページにて通知いたしますので、出願時期には随時ご確認をお願いいたします。

7. 合格発表

(1) 合格発表日

2023年12月22日(金)

(2) 発表方法

インターネット出願サイトのマイページより合否の照会を行ってください。

合格発表日の13:00から出願者全員が合否結果を照会できます。

※詳細は巻末の「合否照会の方法」をご参照ください。

8. 入学手続について

- (1) 入学手続には、入学手続書類の提出と入学手続金の納入が必要となります。入学手続金の納入は2段階方式です。下記の第1回入学手続期間内に**入学金のみ**を納入し、第2回入学手続期間内に入学金を除く学費等入学手続金を納入してください。
- (2) 今後、本学の2024(令和6)年度一般選抜や大学入学共通テスト利用選抜に出願し、合格後に、入学先の学科または学系の変更を希望される場合は、学校推薦型選抜(公募)で入学予定の学科または学系への辞退手続が必要となります。なお、この辞退手続に伴い、すでに納入された入学金の返金はできませんので、ご注意ください。
- (3) インターネット出願サイトのマイページ内にある“合格者ポータルページ”より各種手続を行ってください。詳細は、巻末の「入学手続の方法」をご参照ください。
- (4) **入学手続期間内に入学手続を完了しない場合は、入学辞退として扱います。**

第1回入学手続期間 ※入学金のみ納入	2023年12月22日(金)～2024年1月5日(金)
第2回入学手続期間 ※入学金を除く学費等入学手続金の納入及び入学手続書類の提出	2024年1月12日(金)～2024年1月22日(月)

9. 入学手続金

- (1) 2024(令和6)年度入学生の入学手続金は下表のとおりです。
受託諸会費は現在未定のため、2023(令和5)年度の金額を記載しています。
- (2) 納入済の入学手続金のうち、入学金についてはいかなる理由があっても返還できません。
入学金を除く学費及び受託諸会費については、所定の手続きにより返還いたします。
返還手続きの詳細は、本学インターネット出願サイト内の合格者ポータルページで確認してください(1月中旬頃掲載予定)。
- (3) 入学後、ご事情により休学される場合は、休学在籍料として半期60,000円(工学部第二部は半期30,000円)の納入が必要です。
- (4) 後期分学費は、入学後に納入していただきます。

2024(令和6)年度入学生 入学手続金

(単位:円)

		入学金	授業料	受託諸会費	合計	
システムデザイン工学部 (全学科共通)	入学時納入金	250,000	700,500	20,660	971,160	
	年額	250,000	1,401,000	20,660	1,671,660	
未来科学部	建築学科	入学時納入金	250,000	721,000	20,660	991,660
		年額	250,000	1,442,000	20,660	1,712,660
	情報メディア学科 ロボット・メカトロニクス学科	入学時納入金	250,000	700,500	20,660	971,160
		年額	250,000	1,401,000	20,660	1,671,660
工学部 (全学科共通)	入学時納入金	250,000	700,500	20,660	971,160	
	年額	250,000	1,401,000	20,660	1,671,660	
理工学部 (全学系共通)	入学時納入金	250,000	680,500	20,660	951,160	
	年額	250,000	1,361,000	20,660	1,631,660	

(単位:円)

		入学金	授業料		受託諸会費	合計
			基礎額	履修単位 従量額 ^注		
工学部第二部 (全学科共通)	入学時納入金	130,000	148,050	入学後に履修が確定してから納入	16,760	294,810
	年額	130,000	296,100	13,400× 履修単位数	16,760	442,860 + 履修単位従量額

注:1単位13,400円に履修単位数を乗じた履修単位従量額を納入していただきます。

10. 第2年次以降の学費について

<参考>

第2年次以降の学費は下表のとおりですが、留年した場合は正規進級学年次の学費が適用されます。
学費は、前期・後期の年2回に分けて納入していただきます。

2024(令和6)年度入学生 第2年次以降の学費(年額)

(単位:円)

		年次	授業料	受託諸会費	合計
システムデザイン工学部 (全学科共通)		第2年次	1,425,000	未定	1,425,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,479,000	未定	1,479,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,503,000	未定	1,503,000 + 受託諸会費
未来科学部	建築学科	第2年次	1,466,000	未定	1,466,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,520,000	未定	1,520,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,544,000	未定	1,544,000 + 受託諸会費
	情報メディア学科 ロボット・メカトロニクス学科	第2年次	1,425,000	未定	1,425,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,479,000	未定	1,479,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,503,000	未定	1,503,000 + 受託諸会費
工学部 (全学科共通)		第2年次	1,425,000	未定	1,425,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,479,000	未定	1,479,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,503,000	未定	1,503,000 + 受託諸会費
理工学部 (全学系共通)		第2年次	1,385,000	未定	1,385,000 + 受託諸会費
		第3年次	1,439,000	未定	1,439,000 + 受託諸会費
		第4年次	1,463,000	未定	1,463,000 + 受託諸会費

(単位:円)

	年次	授業料		受託諸会費	合計
		基礎額	履修単位 従量額 ^注		
工学部第二部 (全学科共通)	第2年次	296,100	13,400 × 履修単位数	未定	296,100 + 履修単位従量額 + 受託諸会費
	第3年次	296,100	13,400 × 履修単位数	未定	296,100 + 履修単位従量額 + 受託諸会費
	第4年次	296,100	13,400 × 履修単位数	未定	296,100 + 履修単位従量額 + 受託諸会費

注:1単位13,400円に履修単位数を乗じた履修単位従量額を納入していただきます。

11. 入学前教育の実施について

【システムデザイン工学部・未来科学部・工学部・工学部第二部】

本学では、合格者(入学予定者)に対し、「入学前教育」を実施しています。DVD・Web 動画による講義、レポート課題の提出などによる学習指導を行う予定です。

なお、実施科目、教育方法は学科によって異なります。「入学前教育」の詳細は、合格発表後にご案内いたします。

【理工学部】

本学では、合格者(入学予定者)に対し、「入学前教育」を実施しています。実施科目は、数学、物理学、化学、英語の4科目を予定しております。

「入学前教育」の詳細は、合格者ポータルページ等にてご案内いたします。

12. 入学後に使用するパソコンについて

- 本学では、各自がノートパソコン(理工学部では、入学する学系によってすぐに購入する必要があるかどうかは異なる)を保有し勉学に活用する教育が行われます。
- 準備していただくパソコンの機能及び性能、推奨機種等の詳細については、入学案内書類及び合格者ポータルページにてお知らせする予定です。

※入学後に、パソコン購入目的を対象とした大学独自の奨学制度(学生支援奨学金/貸与)が用意されています。

13. その他

(1) JABEEプログラムについて

技術者教育の分野では国際的な同等性を確保することが重要であり、本学では JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education: 日本技術者教育認定機構) の認定を受けた教育プログラムを実施しています。JABEE プログラム修了者は、国際的に通用する技術者に必要な基礎教育を完了したものと見なされ、将来技術者として海外で働く場合にも有効な手助けとなります。

【工学部電気電子工学科JABEEプログラム】

- 電気電子工学科では、JABEE (日本技術者教育認定機構) 認定技術者教育対応プログラムを実施し、必要要件を満たした場合はJABEEプログラム(電気・電子及び関連の工学分野)修了生とする予定です。
- JABEEプログラムを修了しますと、技術士(国家試験)の第一次試験が免除され「技術士補」の資格を得ることができ、専門技術者としての活躍の場が拡大します。

【理工学部理工学科建築・都市環境学系JABEEプログラム】

- 理工学部では2年次進級時に主コースと副コースを選択します。このうち、建築・都市環境学系の建築コースと都市環境コースのうち、いずれかを主コース、他方を副コースとして選択し、必要要件を満たした場合はJABEE教育プログラム(土木及び関連の工学分野)修了生とすることが可能です。詳細は、建築・都市環境学系(049-296-0307)に直接お問い合わせください。
- JABEEプログラムを修了しますと、技術士(国家試験)の第一次試験が免除され技術士補の資格を得ることができ、専門技術者としての活躍の場が拡大します。

(2) 個人情報の取扱い

- 出願及び入学手続で提出いただいた個人情報は、入学者選抜、合格発表、入学手続及びこれらに付随する事項、並びに統計的集計、高等学校等への情報提供(個人名は非公表)を行うために利用します。
- これらの業務の一部を、東京電機大学が指定した業者に委託することがあります。その場合、個人情報を委託業者に提供することがありますが、提供する情報は必要な範囲内に限定します。予めご了承ください。

(3) 国の教育ローン(日本政策金融公庫)制度について

本学に入学・在学する学生・保護者の方は日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込むことができます。「国の教育ローン」は、教育に必要な資金を融資する公的な制度です。

詳細は、下記日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。教育ローンコールセンターに直接お問い合わせください。

日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター

TEL:0570-008656 または 03-5321-8656(月～金 9:00～19:00)

日本政策金融公庫 国の教育ローン ホームページ

<https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html>

(4) 高等教育の修学支援新制度

本学は、文部科学省「高等教育の修学支援新制度」の対象校として認定されています。

本制度は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、経済的な理由で進学や修学を断念することがないように、要件を満たした学生を対象に、授業料及び入学金の減免と給付型奨学金の支援を受けることができるものです。

原則、日本学生支援機構の給付型奨学金に採用となった方が、授業料等減免の対象者として認定されます。

給付型奨学金に採用された方は、入学後に各学部の担当窓口にて、給付型奨学金、入学金及び授業料減免の申請を行ってください。減免対象者として認定された後、減免相当額を還付(例年7月～8月頃予定)します。

また、本学では、給付型奨学金の採用候補者を対象として、入学手続きにおいて入学金を除いた授業料等の納入期限を猶予する対応も行っています。納入期限猶予の手続き方法については、本学ウェブサイト(<https://www.dendai.ac.jp/prospective-students/>)にてご確認ください。

(5) 日本国以外の国籍を有する方へ

日本国以外の国籍を有する者は、本学入学時に出入国管理及び難民認定法に基づく本邦で活動するために必要とされる適切な在留資格を保有している必要がありますので、事前に必ずご確認ください。

なお、工学部第二部(夜間学部)に入学した場合、法令により本学において在留資格「留学」の取得及び更新はできません。

(6) 身体障がい者等への特別支援と受験上の合理的配慮について

本学における特別支援(施設、設備、サポート体制他)の整備状況、ならびに特別支援ニーズへの対応可能範囲は、学科・学系での学びの分野やカリキュラムとも関係して、キャンパス及び学科・学系により異なります。受験方法や入学後の学修環境・支援において、ご本人様にとっての不利益を生じさせないために、出願に際しては事前に本学入試センターまでご相談ください。

(7) 選考会場

本学 Web ページにて案内しています。

<https://www.dendai.ac.jp/access/>

インターネット出願の手引き

出願は、この手引きに従って以下の手順で行ってください。

インターネット出願登録だけでは出願が完了しません。

必ず「志願票」および出願書類を郵送してください。

〔出願手順〕

- STEP 1 予め写真データを準備してください
- STEP 2 インターネット出願サイトで必要事項を登録してください
- STEP 3 入学検定料を納入してください
- STEP 4 出願書類を郵送してください
- STEP 5 出願が受理されるまでお待ちください
- STEP 6 受験票発行日に受験票を確認してください

■ インターネット出願における注意事項

- インターネット出願登録で不具合が起きた時は、必ず東京電機大学入試センターまでお問い合わせください。特に出願期間終了後は一切の対応ができかねますので、必ず出願期間内に余裕をもってご連絡ください。
- この手引きに掲載している画面の構成や内容は変更される場合があります。実際の画面の指示に従って操作してください。

STEP1 予め写真データを準備してください

インターネット出願登録の過程で、顔写真データをアップロードする手順があります。予め写真データを準備してください。

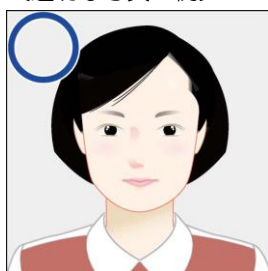
〔登録する写真データの要件〕

- ファイルサイズが 20MB 以下であること。
- ファイル形式は JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）もしくは PNG（拡張子「.png」）であること。
- 縦横の比率は任意です（インターネット出願登録の際に、画面上で確認しながら指定する比率に切り抜きます）。

〔注意点〕

- 出願 3 ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽、背景は無地に限ります。
- 個人が特定しづらいもの、およびアプリ等で加工したものは受付できません。
- 学生服で撮影した写真はご遠慮ください。登録した写真は入学後に学生証にも使用します。
- 紙の写真は使用できません。また、紙の写真をスマートフォン等で撮影したものも使用できません。必ず本人を直接撮影してください。

〔適切な写真の例〕



- * 背景は無地（白、青、またはグレー）の壁をバックに撮影してください。
- * 壁に近づきすぎると影が濃く出て輪郭が分からなくなる恐れがあります。
- * 蛍光灯の下で撮影すると顔に影がかかってしまう恐れがあります。

〔適切でない写真の例〕 以下のような写真は受付できません。



背景や顔に影がある



枠からはみ出ている



小さく写っている



背景が無地でない／他の物が写り込んでいる



ぼやけている



髪で目元や顔の輪郭が隠れている



正面を向いていない



照明がメガネに反射して目元が鮮明でない

STEP2 インターネット出願サイトで必要事項を登録してください

インターネット出願サイトは出願開始日の **10:00** から出願登録ができるようになります。

STEP2- (1) 本学 Web サイトから、インターネット出願サイトにアクセスしてください。

出願期間中は、本学の Web サイトに「インターネット出願サイト」にリンクしたバナーを掲出します。本学の Web サイトで、出願する選抜の最新の情報を確認したうえでバナーをクリックして、「インターネット出願サイト」へ移動してください。

〔東京電機大学 受験生・高校生の方〕

<https://www.dendai.ac.jp/prospective-students/>



※バナーのデザインは変更される場合があります。

STEP2- (2) 画面の指示に従って必要事項を入力してください。

マイページを作成後、新規出願や出願履歴の確認等を行うことができます。また、出願登録及び入学検定料納入完了後には志願票や受験票の印刷、合格者ポータルページの参照等を行うことができます。



①出願登録開始
(マイページ登録)



②マイページ
(出願する選抜・学部・学科・学系を選択)



③出身校の登録
(※選抜種別によってはこの画面を利用しない場合もあります)



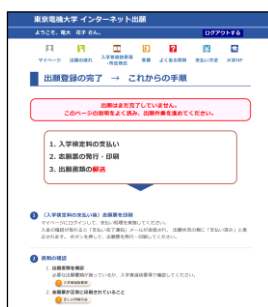
④個人情報等の登録



⑤写真の登録



⑥出願登録内容の確認



⑦登録完了画面
(まだ出願は完了していません)



⑧マイページに戻る
(STEP3 入学検定料の納入に進む)

※ 本学システムで扱うことができない漢字は、受験の際に使用することができません。

利用できない漢字を入力した場合は出願登録画面でエラーとなりますので、代替の漢字を使用してください。

※ 総合型選抜（はたらく学生）は入学検定料が免除されるため、このSTEP 3の手順は必要ありません。出願登録後すぐに志願票が印刷できるようになりますので、STEP 4に進んでください。

STEP3 入学検定料を納入してください

出願登録が完了したら、マイページに戻り、「出願登録を完了して支払う」ボタンを押してください。画面の指示に従って支払い方法を選択・確定し、各支払い方法に従って入学検定料を納入してください。



①マイページで「出願登録を完了して支払う」を押す



②支払い方法を選択する



④納入が完了すると「支払い済み」が表示され、志願票が出力できるようになる

③入学検定料を納入する

お支払い方法

コンビニエンスストア、クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)のいずれかでお支払いください。

コンビニエンスストア

現金支払い

コンビニ設置のATMは利用できません。コンビニでは現金のみの取扱いとなります。



[Loppi]

[各種番号をお持ちの方]を選択

[受付番号(6桁)]を入力し、[次へ]ボタンを押す

お申込み時に登録した電話番号を入力し「次へ」を押す

内容確認後、「了解」ボタンを押す

端末から出力された申込券を持ってレジでお支払い

[Famiポートまたはマルチコピー機]

[代金支払い]を選択

Famiポート:
[各種番号をお持ちの方はこちら]

マルチコピー機:
[番号入力]

Famiポート:[企業コード][注文番号]
マルチコピー機:[第1番号][第2番号]

端末から出力された申込券を持ってレジでお支払い

[レジへ]

レジで「オンライン決済」を申し込む

レジ画面で決済番号を入力

内容確認後、レジでお支払い

[レジへ]

レジで「インターネット支払い」と伝える

お客様側のレジ画面にて
[受付番号][確認番号]を入力

支払い内容の確認画面が表示

OKを押してお支払い

[レジへ]

店員の方へ「インターネット支払い」をする旨を伝え、「払込票番号」を伝えます。発行した「払込票」を渡しても構いません。

お支払い

※支払方法、コンビニは変更になる場合があります。
※店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります。

金融機関ATM(ペイジー)

現金支払い/キャッシュカード

クレジットカード

ゆうちょ銀行・pay-easy対応ATMを利用

[税金・各種料金(ペイジー)]を選択

収納機関番号を入力

お客様番号・確認番号を入力

支払い方法を選択
(現金またはキャッシュカード)し、
検定料を支払う



※現金取扱いの場合は、検定料の総額が10万円未満の場合のみ支払いが可能です。10万円を超える場合は、キャッシュカードを利用してください



VISA, Master, JCB, American Express, Diners

※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません

■注意事項

- 支払方法を確定すると、実際の入金の有無に関わらず出願内容の変更・取消し・修正はできなくなります。支払方法の確定をする前に必ず出願内容を再確認してください。
- ローソン・ミニストップ・セイコーマート支払いの場合は、マイページに入金情報が反映されて志願票が印刷できるようになるまでに最長で2時間程度を要する場合があります。この反映までの時間を理由とした出願期限の延長はいたしませんので、余裕をもって出願手続きを行ってください。
- 一度納入された入学検定料は返還しません。ただし、本学が定める入学検定料返還事由に該当し、所定の方法で行った申請が本学によって受理された場合のみ、入学検定料を返還します。詳細は以下の本学ホームページよりご確認ください。

[東京電機大学入学者選抜/大学院入試 入学検定料返還申請について]

https://www.dendai.ac.jp/about/admission/undergraduate/kenteiryuu_henkanshinsei.html



※ 出願書類を所属の学校・団体へ提出するよう指定されている選抜については、個人で郵送せずその指定に従ってください。

STEP4 出願書類を郵送してください

出願登録が完了し、入学検定料を納入すると、「志願票」が印刷できるようになります。



「志願票」と、出願に必要な書類（本要項内の「出願について」の項目を参照）を本学へ郵送してください。例え出願登録を完了し入学検定料を納入していても、定められた期限までに「志願票」および出願書類一式を送付しないと出願となりません。

〔郵送方法〕

出願登録完了後、マイページより「志願票」と共に「宛名ラベル」を取得できますので、市販の**角型2号の封筒**に印刷した「宛名ラベル」を貼り、「志願票」および出願書類一式を入れて、必ず**郵便局の窓口より簡易書留・速達**で郵送してください。

STEP5 出願が受理されるまでお待ちください

出願状況は、マイページに表示されます（メール等での通知はいたしません）。出願状況が「受理」に変わるまで、最長で受験票発行日までかかります。ご自身で具体的な不備があったことに気付いた場合を除き、受験票発行日より前に受理状況をお問い合わせいただくことはご遠慮ください。

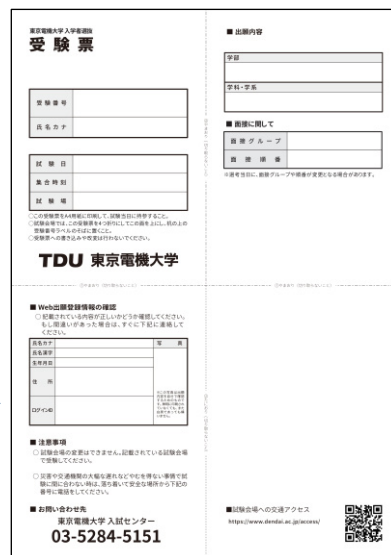
STEP6 受験票発行日に受験票を確認してください

受験票が発行されていない場合は受験できません。必ずマイページ上で受験票が発行されたことを確認してください。

- 受験票は、インターネット出願登録、検定料の納入、出願書類送付の全てを完了させ、本学で出願書類が受理された方のみ、受験票発行日の13:00以降にマイページからPDFファイルとして取得できるようになります。紙の受験票は発行しません。また、本学からハガキ等で受験票を郵送することはありません。
- 受験票発行日を過ぎてもマイページから受験票が取得できない場合は、必ず東京電機大学入試センターに電話で連絡をしてください。受験票が発行されていない場合は受験ができません。
- 試験当日は、必ず**A4サイズ・タテ向き**で印刷した受験票を試験会場に持参してください。スマートフォンの画面提示等では受験できません。

〔受験票の取得方法〕

マイページから「受験票を表示する」のボタンを押して、受験票を取得してください。



合否照会の方法

合否発表は以下の方法で行います。

発表方法	合否発表日時	発表対象者
Web 合否照会 (マイページより)	合格発表日当日 13:00 ~	全志願者



- ① マイページにログインして、「合否照会」のボタンを押してください。
- ② 移動先のページの指示に従って、合否を確認してください。

※画面の構成は変わる場合があります。実際の画面に従って操作してください。

注意事項

- 合格発表は、志望した学科・学系の受験番号で発表します。
- 電話・メール等による合否結果についての問い合わせには一切応じられません。
- 表示内容の正確性には万全を期しておりますが、個々の閲覧環境が原因で表示に乱れがあっても、本来の合否結果が変更されることはありません。
- 合格通知書は送付されません。合格者ポータルページから電子ファイル（PDF）が取得できます（次頁の「入学手続の方法」を参照）。

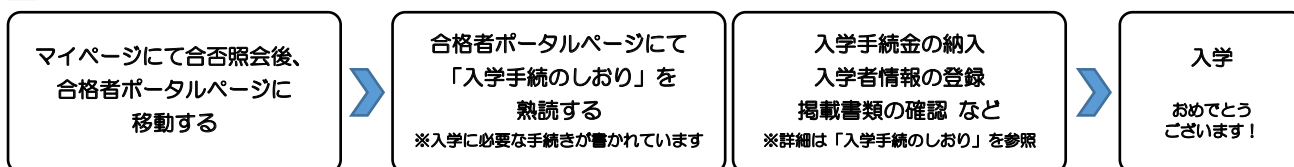
合否照会が続いて行うこと

- 入学の意思がある場合は、合否照会が続いて、定められた期限までに入学手続を行う必要があります。次頁の「入学手続の方法」に沿って手続きを行ってください。

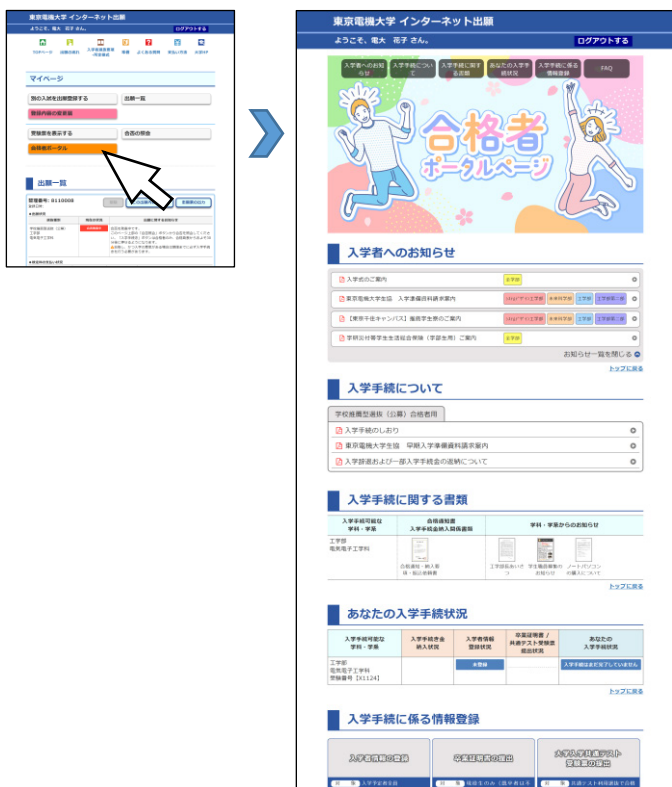
入学手続きの方法

入学手続きは、受験生自身で「合格者ポータル」ページ上での案内と掲載資料を確認のうえ、進めていただきます。期限までに手続きを行わない場合は入学辞退者として扱いますので十分に注意してください。

入学手続きの流れ



〔合格者ポータルへの移動方法と入学手続きについて〕



- ① 予めマイページにて合否照会を行ってください（前頁を参照）。
- ② 合格者ポータルページへの入り口ボタンは、合格者のみが、各選抜の合格発表後 30 分程度で押せるようになります。ボタンが押せるようになったら、合格者ポータルページに移動してください。
- ③ **まず最初に、合格者ポータルページに掲載されている「入学手続きのしおり」を熟読してください。入学に必要な具体的な手続きはすべてこれに記載されています。**
- ④ 「入学手続きのしおり」で説明されている、各種の書類（合格通知書、入学手続き金納入要項、入学手続き金振込用紙等）は、合格者ポータルページから電子ファイル（PDF）で取得できます。

※画面の構成は変わる場合があります。実際の画面に従って操作してください。

注意事項

- 合格者であるにも関わらず、合否発表後 30 分以上経っても合格者ポータルページに移動できない場合は、すぐに本学入試センターへ電話にてお問い合わせください。パソコンや出願サイトの不具合も含め、いかなる理由があっても手続き期間の延長はいたしません。お問い合わせは必ず手続き期間内に余裕をもって行ってください。
- 入学の意思がある場合は、必ず合格した選抜種別の入学手続き期間内に入学手続き金を納入してください。**入学手続き期間内に入学手続き金の納入を完了しない場合は、入学辞退者として扱います。**

TDU 東京電機大学

【お問い合わせ先】

東京電機大学 入試センター

〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番

電 話: 03-5284-5151

F A X: 03-5284-5243

メール: nyushi@jim.dendai.ac.jp

<https://www.dendai.ac.jp/>